

貼合条件（例）

前処理：

1.樹脂板養生 (アウトガス対策) 100 °C x 1 hour.

2.プラズマ処理 (密着力強化表面処理)

※樹脂板とタッチセンサーやLCD表面の処理.

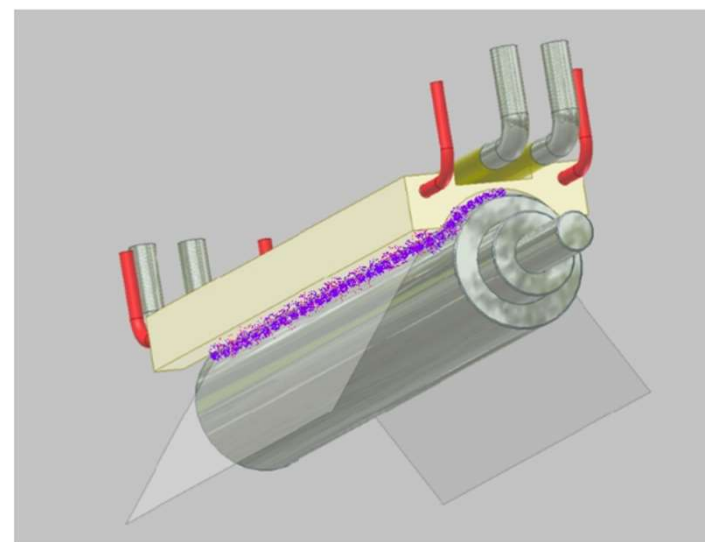
貼合の条件：

- ・ 温度：25°C
- ・ 圧力：0.5Mpa
- ・ 真空度： $\leq 100\text{Pa}$
- ・ 時間：20sec

オートグレーブ条件：

- ・ 温度：50°C
- ・ 圧力：0.5Mpa
- ・ 時間：20min

プラズマ処理



※KGKでOCA加工、貼合試作を請け負います。

貼合プロセス（例）

★真空貼合プロセス.

貼合手順：

- ①OCAをタッチセンサーやLCDに貼合（大気）
- ② ①を樹脂板へ貼合（真空）
- ③オートグレーブ.

真空貼合装置

